

Co/Si 다층박막에서 고상확산에 의한 실리사이드 생성에 관한 연구
(A Study on the Silicide Formation by Solid State Diffusion
in Co/Si Multilayer Thin Films)

심재엽, 지웅준, 곽준섭, 최정동, 백홍구
연세대학교 금속공학과 정연 및 박막재료연구실

1. 서론

최근 반도체 lithography 기술과 미세 가공 기술이 발달됨에 따라 반도체 소자의 초고집적화 및 미세화가 이루어지고 소자의 고기능화, 고신뢰화가 요구되고 있다. 이러한 추세와 같이하여 게이트전극과 내부배선재료로 고용점 금속들의 실리사이드가 그동안 사용되어온 다결정 실리콘을 대체하고 있다. 이러한 실리사이드가 갖추어야 할 요건은 높은 전기전도도, 낮은 ohmic contact 저항, 점착성 그리고 열적, 화학적 안정성이다.

실리사이드는 단결정 실리콘 웨이퍼위에 금속을 증착하거나 실리콘과 금속을 번갈아 증착한 후 열처리 과정을 통하여 제조되는데, 증착 또는 열처리 시에 많은 계에서 고상확산을 통하여 비정질상 및 결정질상이 순차적으로 생성된다.

이에 본 연구에서는 이원계 박막에서 비정질상의 생성여부를 예측할 수 있는 유효구동력 개념과 결정상의 생성을 예측할 수 있는 유효생성열 개념을 이용하여 Co/Si 다층박막을 고진공 열처리시 생성되는 비정질상과 결정상의 전이를 조사하고, 각 상이 생성되는 반응기구를 고찰하였다.

2. 실험방법

본 실험에서는 3개의 타겟을 설치할 수 있는 RF Magnetron Sputtering 장치를 이용하여 진공을 깨지 않고 10층의 Co/Si 다층박막을 얻을 수 있었다. 기판은 Si wafer와 NaCl 단결정을 사용하였으며 target으로 사용한 Co 와 Si 은 각각 99.95%와 99.999%의 고순도였다. 유확산 펌프에는 액체질소 트랩을 설치하여 pumping oil에 의한 역류를 최소화 하였으며 초기진공도는 7×10^{-7} Torr 이하로 유지하였다. 반응기체는 Ar(99.999%)을 사용하였으며 조업압력을 항상 5×10^{-3} Torr로 유지하였다.

NaCl에 증착한 시편은 1~2mg의 양으로 무게를 재어서 DSC분석에 사용하였으며 DSC 분석은 constant scanning mode와 isothermal mode로 수행되었으며 이 두 mode를 이용하여 각 반응이 일어나는 정확한 온도와 각 상이 생성되는 기구를 규명하고 그 반응의 활성화 에너지를 구하였다. 또한 DSC를 거친 시편을 XRD를 이용하여 상분석을 하였다. 단결정 Si wafer에 증착된 시편은 금속열처리로에서 열처리한 후 XRD, AES, XTEM을 이용하여 생성된 상을 분석하고 원소의 깊이 분포, 계면형상을 조사하였다.

3. 결과 및 고찰

증착된 Co 층은 다결정질이며 Si층은 비정질상이었다. Co 층과 Si 층 사이에는 증착시에 생성된 비정질의 interlayer가 존재하였으며, 이 비정질은 열처리 시에 잘 성장하지 않고 결정질로 변화하였다. 열처리 온도가 증가함에 따라 Co_2Si , CoSi , CoSi_2 등이 생성되었다. 이러한 결과는 Kwak 등이 제인한 유효구동력 개념과 Choi 등이 제안한 유효생성열 개념과 잘 일치하였다.

4. 참고문헌

- 1) B. S. Lim et al., J. Appl. Phys. 61(1987), 5027
- 2) H. Miura, E. Ma, and C. V. Thompson, J. Appl. Phys. 70(1991), 4287
- 3) K. N. Tu et al., J. Appl. Phys. 53(1982), 4406
- 4) 곽준섭, 백홍구, 한국진공학회 투고중
- 5) 최정동, 백홍구, 한국진공학회 투고중